

環境負荷化学物質含有量

環No.2019-46
2019年4月11日

製品名 : MKY46
部品質量 (mg) : 550

株式会社ステップテクニカ 管理部
E-mail kanri_step@steptechnica.com

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン(Si)	7440-21-3	10.0346	98.5805	1.8245	素子材料
	ヒ素(As)	7440-38-2	1.00E-04	0.001	0.00E+00	ドーパント
	ホウ素(B)	7440-42-8	1.00E-03	0.0098	2.00E-04	ドーパント
	リン(P)	7723-14-0	3.20E-03	0.0317	6.00E-04	ドーパント
	チタン(Ti)	7440-32-6	4.17E-02	0.4101	7.60E-03	回路形成
	タングステン(W)	7440-33-7	9.70E-03	0.0952	1.80E-03	回路形成
	銅(Cu)	7440-50-8	3.00E-04	0.0027	0.00E+00	回路形成
	アルミニウム(Al)	7429-90-5	8.85E-02	0.869	1.61E-02	回路形成
チップマウント	銀(Ag)	7440-22-4	0.817	77.0003	0.1485	導電性材料
	アクリル樹脂	---	0.2122	19.9996	0.0386	接合材料
	エポキシ樹脂	---	0.0318	3.0001	0.0058	接合材料
リードフレーム	銅(Cu)	7440-50-8	213.753	96.5646	38.8642	フレーム材料
	鉄(Fe)	7439-89-6	5.0321	2.2733	0.9149	フレーム材料
	銀(Ag)	7440-22-4	2.5725	1.1621	0.4677	銀メッキ
ワイヤ	金(Au)	7440-57-5	2.4056	100	0.4374	配線
外部端子メッキ	スズ(Sn)	7440-31-5	13.6469	100	2.4813	端子表面処理材料
パッケージ	エポキシ樹脂	---	41.285	13.7	7.5062	封止樹脂材料
	有機リン化合物	---	3.0135	1	0.5479	封止樹脂材料
	シリカ(SiO2)	60676-86-0	256.1472	85	46.5723	封止樹脂材料
	カーボン(C)	1333-86-4	0.9041	0.3	0.1644	封止樹脂材料
含有量合計			550		100	